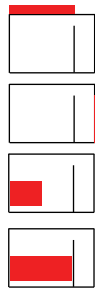




Werbebanner auf www.SMT-Verlag.de

emv-esd



Typ	Größe in Pixel	Formate	Preise pro Woche
Super Banner	728 x 90	GIF/JPG/Flash	300 €
Wide Skyscraper	160 x 600	GIF/JPG/Flash	250 €
Rectangle	180 x 150	GIF/JPG/Flash	150 €
Medium Rectangle	300 x 250	GIF/JPG/Flash	250 €

Sie können selbstverständlich auch jedes andere Format wählen, inklusive Video. Bitte fragen sie bei uns an!

CADS

Redaktion + Vertrieb

Dipl.-Ing. (FH Jost Dennier)
info@smt-verlag.de
www.smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
55218 Ingelheim
Tel: +49 (0)6132 4316-47
Fax: +49 (0)6132 4316-49

Anzeigenverkauf

Johann Bylek
Tel: +49 171 412 9443
E-mail: johann.bylek@t-online.de

MEDIADATEN 2018

THEMEN
TERMINE
PREISE

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung



emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT & AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

CADS

CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG
JAHRGANG 30
NOVEMBER / DEZEMBER 2017
WWW.SMT-VERLAG.DE
30974
productronica 2017

11/12 SMT

ASM AUF DER PRODUCTRONICA 2017 – GROSSE FORTSCHRITTE AUF DEM WEG ZUR SMART SMT FACTORY

Flexible Reinigungsmethoden Leiterplatten: Qualität ist, was zählt Intelligente EMV Kunststoffe – Nutzung alternativer Schirmkonzepte

SMT Smart Network
powered by ASM

- **Herausgeber:** Jost Dennier
- **Redaktion:** Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier
Anschrift: Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD
 Oberer Schenkgarten 1
 55218 Ingelheim
 Tel.: +49 (0)6132 43 16 47
 Fax: +49 (0)6132 43 16 49
 E-Mail: info@smt-verlag.de
 Web: www.smt-verlag.de
- **Anzeigen:** Johann Bylek
 Telefon: +49 171 412 9443
 E-Mail: johann.bylek@t-online.de
- **Inhaber:** Jost Dennier
- **Verlag:** SMT-VERLAG
 Oberer Schenkgarten 1
 55218 Ingelheim
- **Jahrgang:** 31. Jahrgang 2018
- **Erscheinungsweise:** 7 x in 2018
- **Erscheinungs-/Redaktionsplan:** siehe Seite 5/6
- **Bezugspreise:**

Jahresabonnement:	58,00 Euro inkl. Versand
Einzelheft:	9,00 Euro
Jahresabo: EMV-ESD bzw. CADS	29,00 Euro inkl. Versand

■ Kurzcharakteristiken:

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken wie Verifikation, Design, Routing, Signalintegrität u s w.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

■ **Auflagen-Analyse:** Intern (30.09.2016 -01.10.2017)

■ **Druckauflage:** 9500

■ **Tatsächlich verbreitete Auflage**

im Jahresdurchschnitt: 9219

■ **Verkaufte Auflage:** 812

■ **Freistücke:** 8157 pro Ausgabe

■ **Rest-, Archiv- und Belegexemplare:** 250 pro Ausgabe

■ Geographische Verbreitungsanalyse

Wirtschaftsraum	Anteil an der Auflage in %	
Inland		
Postleitzahl 0	221	2,4
Postleitzahl 1	325	3,5
Postleitzahl 2	524	5,7
Postleitzahl 3	725	7,9
Postleitzahl 4	619	6,7
Postleitzahl 5	712	7,7
Postleitzahl 6	1132	12,3
Postleitzahl 7	1965	21,3
Postleitzahl 8	1606	17,4
Postleitzahl 9	812	8,8
Ausland		
Schweiz	124	1,3
Österreich	115	1,2
Großbritannien	93	1,0
Niederlande	91	1,0
Sonstiges Ausland	155	1,7
Gesamtauflage	9219	100,0

Branchen-/Wirtschaftszweige

Nr. Grundsystematik	Empfängergruppen	Exemplare	%
242	Maschinenbau	619	6,7
243	Datenverarbeitung/ Büromaschinen	155	1,7
244	Fahrzeugbau	227	2,5
248	Luft- und Raumfahrt	291	3,2
250	Elektronikfertigung	3746	40,6
	Unterhaltungselektronik	156	1,7
	Medizin techn. / Optik	309	3,4
	Leiterplattenhersteller	243	2,6
	Ing. Büros/Dienstleistung	1221	13,2
	Mess- und Regeltechnik	408	4,4
5	Nachrichtentechnik / Verkehr	821	8,9
	Bauelemente-Hersteller	246	2,7
	Stromerzeugung	64	0,7
9	Ausbildung / Forschung	637	6,9
	Sonstige Branchen	76	0,8
Tatsächlich verbreitete Auflage		9219	100,0

Betriebsgröße

	Exemplare	%
1 bis 9 Beschäftigte	1475	16,0
10 bis 49 Beschäftigte	1137	12,3
50 bis 99 Beschäftigte	792	8,6
100 bis 499 Beschäftigte	2241	24,3
500 bis 999 Beschäftigte	833	9,0
1000 und mehr Beschäftigte	2741	29,7
	9219	100,0

Betriebliche Funktion

	Exemplare	%
Unternehmensleitung	612	6,6
Techn. Management	2181	23,7
Forschung/Entwicklung	2499	27,1
Konstruktion	711	7,7
Fertigung	1926	20,9
Qualitätskontrolle, Test	514	5,6
Verkauf	317	3,4
Marketing / Werbung	395	4,3
Studenten	43	0,5
Hochschulen/Sonstige	21	0,2
	9219	100,0

Zeitschriftenformat: DIN A4 210 breit x 297 hoch mm
Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm

Satzspiegel: 185 breit x 260 hoch mm

Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro

Format	Breite x Höhe bei Anzeigen pro Jahr	Maße angeschnitten	Preise für 4-Farbdruck				
			1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303	4.780,00	4.541,00	4.302,00	4.063,00	3.824,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303	3.700,00	3.515,00	3.330,00	3.145,00	2.960,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198	3.260,00	3.097,00	2.934,00	2.771,00	2.608,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133	2.900,00	2.755,00	2.610,00	2.465,00	2.320,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90	2.420,00	2.299,00	2.178,00	2.057,00	1.936,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303	1.740,00	1.653,00	1.566,00	1.479,00	1.392,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36	900,00	855,00	810,00	765,00	720,00
1/16-Seite	46 x 62 oder 93 x 31		480,00	460,00	420,00	410,00	390,00

Preise für Vorzugsplätze: 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%

Sonstige Platzierungsvorschrift: +10% auf den Grundpreis
Anschnittzuschläge werden **nicht** berechnet

Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 4,00

Bankverbindung:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00
BIC-Code: MVBMD55 IBAN: DE8355190000787587013

Zahlungsbedingungen: Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit
2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

Einhefter/Einkleber:

Papiergewicht: 80 bis 120 g/m²

2 Seiten (nur Einkleber)	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

Beilagen: Teilbeilagen sind möglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto 290,00	bis 50 g/1000 inkl. Porto 390,00
-------------------------------------	-------------------------------------

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF-Dateien als Druckunterlagen werden bevorzugt.

Versandanschrift: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,
D-55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,
E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und
Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

Termine	Schwerpunktthemen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Messen
Ständige Schwerpunkte	Advanced Packaging Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Marktübersichten	EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, Logiksynthese, Simulation	Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen	
SMT Januar / Februar mit EMV-ESD 1 Messeheft EMV 2018 Redaktionsschluss 30.01.2018 Anzeigenschluss 05.02.2018 Erscheinungstermin 12.02.2018	Reparatur/Rework, Löttechnik, Bestücktechnik, Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer Reinraumtechnik Baugruppentest, Halbleitertest, AOI Marktübersicht: Steckverbinder		Vorschau EMV 2018 Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik ESD, Produktsicherheit	EMV 20. - 22.02.2018 Düsseldorf APEX 27.02. - 01.03.2018 San Diego
SMT März / April mit CADS 1 Redaktionsschluss 10.04.2018 Anzeigenschluss 17.04.2018 Erscheinungstermin 26.04.2018	Vorberichte »SMT Hybrid Packaging« Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober Packaging, Chip-on-Board, Rework Marktübersicht: Lohnfertiger	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		Hannover Messe 23. - 27.04.2018 Hannover
SMT Mai / Juni mit EMV-ESD 2 Messeheft SMT/ Hybrid/ Packaging Redaktionsschluss 09.05.2018 Anzeigenschluss 17.05.2018 Erscheinungstermin 24.05.2018	Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck AOI, AXI, Flying Prober Marktübersicht: Lötssysteme		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1 Nachbericht EMV 2018 Messtechnik Antistatische Materialien Dienstleistungen Störfestigkeit	SMT/Hybrid/ Packaging 05. - 07.06.2018 Nürnberg
SMT Juli / August mit EMV-ESD 3 Redaktionsschluss 09.08.2018 Anzeigenschluss 17.08.2018 Erscheinungstermin 30.08.2018	Packaging, Bestückung, Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Löttechnik Marktübersicht: Siebdrucker		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2 Störfestigkeit Messtechnik Antennen Filter, Stromversorgung	CeBIT 11. - 15.06.2018 Hannover Intersolar Europe 20. - 22.06.2018 München
SMT September / Oktober mit CADS 2 Redaktionsschluss 12.09.2018 Anzeigenschluss 19.09.2018 Erscheinungstermin 28.09.2018	Vorberichte »electronica« Boardhandling, Bonding Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan Marktübersicht: Bestückssysteme	Design, Verifikation, Platzieren Entflechten, Signalintegrität Logische Verifikation		Motek 08. - 11.10. 2018 Stuttgart parts2clean 23. - 25.10.2018 Stuttgart
SMT November mit EMV-ESD 4 MESSEHEFT »electronica 2018« Redaktionsschluss 17.10.2018 Anzeigenschluss 25.10.2018 Erscheinungstermin 02.11.2018	Löttechnik, Bestücktechnik Leiterplatten, Microvias, HDI AOI, AXI, Flying Prober Marktübersicht: Leiterplattenhersteller		Dienstleistungen Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik	Semicon Europe 13. - 16.11.2018 München electronica 13. - 16.11.2018 München
SMT Dezember mit CADS 3 Redaktionsschluss 29.11.2018 Anzeigenschluss 05.12.2018 Erscheinungstermin 14.12.2018	Nachberichte »electronica« Löttechnik, Selektivlöten Dispensen, Bestückung MCM, Board-Test, ICT, AOI, AXI Marktübersicht: Bondsysteme	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		SPS/IPC/DRIVES 27. - 29.11.2018 Nürnberg